



## Editorial

Chers lecteurs/lectrices, au nom de toute l'équipe du bureau IMAPS France, nous espérons que cette pandémie du Covid-19 vous a épargnés, vous ainsi que vos proches.

Nos résultats financiers sur les trois événements **2019**, ayant atteint, **leur niveau optimum** Notre bilan comptable en est ressorti positif pour la première fois depuis plus de 6 ans. Malgré cette réussite commune, vous pouvez vous douter que cette année 2020 va malheureusement nous plonger dans un nouveau déficit dont notre esprit combattif et résilient nous en fera ressortir d'autant plus fier ; on pourrait croire à un éternel recommencement !

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, due à la pandémie Covid-19, un plan de sauvegarde a été discuté et validé par le bureau ; La situation pour l'association et les mesures prises sont les suivantes :

Florence Vireton, notre salariée, est placée en **chômage partiel** en raison d'une activité réduite du fait du report de MiNaPAD. Cet état pourra se prolonger jusqu'au mois de septembre.

L'Espace Hamelin, où se situe notre bureau, va rouvrir partiellement. Florence est donc pour le moment en télétravail partiel.

La situation financière de l'association devrait permettre de maintenir une trésorerie suffisante pour **poursuivre l'activité en 2021** avec des changements structuraux. Les aménagements du chômage partiel mis en place par l'état vont y contribuer.

Pour les événements, nous avons fait preuve d'**agilité** :

- MiNaPAD 2020 est reporté aux 2 et 3 Février 2021
- POWER 2020 est maintenu
- THERMAL 2021 est reporté aux 19 et 20 Mai 2021

Cela va changer nos et vos habitudes et les raisons de ces changements vous en sont détaillées ci-après.

Nous commencerons par revenir sur notre dernier événement, **THERMAL 2020** dont la réussite scientifique a été reconnue par les participants et les orateurs. L'évènement qui aura pu miraculeusement se dérouler juste après les grèves sur la réforme des retraites s'avère être aussi un succès commercial de l'avis de nos exposants.

Et nous redémarrons notre activité événementielle dès la fin du mois de novembre 2020 avec la journée **Micro/Nano POWER** qui se déroulera à Tours ; l'appel à papiers est lancé et nous vous attendons tout aussi nombreux que l'an dernier.

Nous rappelons aussi que vous pouvez partager vos dernières infos avec le reste de nos lecteurs sur la rubrique **Informations diverses** de notre newsletter.

*Alexandre VAL*

A tous nos lecteurs/lectrices, nous rappelons qu'une série de financements flash COVID-19, nationaux et Européens, ont été lancés pour soutenir vos actions, vous trouverez une liste de liens utiles sur le site de la commission Européenne :

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19>

ainsi que les appels ANR

<https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/>

*"Au centre de la difficulté se trouve l'opportunité"*  
(Albert Einstein), celle d'innover ensemble afin de vaincre cette pandémie.

*Sanae BOULAY*

## Calendrier IMAPS France 2020-2021

**12<sup>ème</sup> From Nano to Micro Power Electronics and Packaging Workshop**  
26 Novembre 2020, Tours

**8<sup>ème</sup> Forum MiNaPAD**  
2 et 3 Février 2021 - Grenoble

**16<sup>ème</sup> European Advanced Technology workshop on Micropackaging and Thermal Management**  
19 et 20 Mai 2021 – La Rochelle

*Prochaine édition : Septembre 2020*

## Bilan comptable 2019

**Jean-Yves Soulier – Trésorier**  
**Alexandre Val – Président**

Comme vous le savez, nous n'avons pas encore tenu l'assemblée générale de l'association, qui se tient traditionnellement en septembre. Nous tenons cependant à vous présenter le bilan comptable 2019 déjà disponible.

### Les résultats financiers :

**Pour 2018**, les données économiques se décomposent de la façon suivante :

**Charges d'exploitation** : 98911 Euros pour 2018

Fonctionnement Hamelin : 18455 Euros

Charges salariales : 57684 Euros

Autres Frais (gestion, TVA,...) : 22772 Euros

**Chiffre d'affaire** : 149065 Euros

Soit un résultat d'exploitation a été -22353 Euros. Le niveau du fond de roulement s'est maintenu autour de 140 000 Euros grâce à la récupération de factures impayées « client » remontant jusqu'à 2015 !

**Pour 2019**, le budget prévisionnel a été suivi et dépassé ; nous obtenons un résultat positif. Le modèle économique se décompose de la façon suivante :

**Charges d'exploitation** : 94553 Euros pour 2019

Fonctionnement Hamelin : 15335 Euros

Charges salariales : 53080 Euros

Autres Frais (gestion, TVA,...) : 26138 Euros

**Chiffre d'affaire** : 194402 Euros

Soit un résultat d'exploitation estimé à 660 Euros. Le niveau du fond de roulement s'est maintenu lui autour de 130 000 Euros.

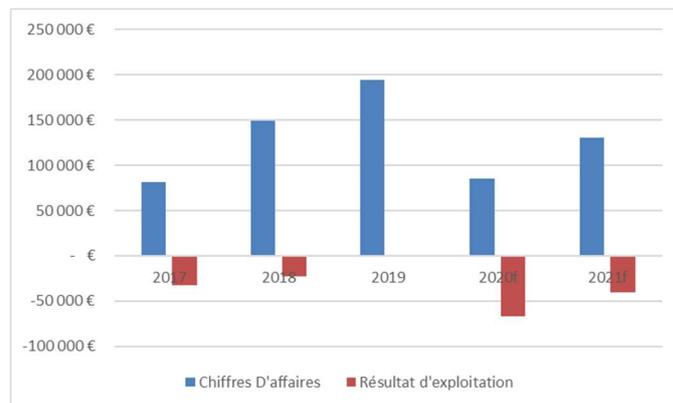
Le budget actualisé tous les mois nous permet de suivre tous les postes de dépenses et de trouver des optimisations encore réalisables.

Ce redressement financier résulte du travail de toute **l'équipe IMAPS France** au sens large. Les responsables des événements Thermal, MiNaPAD, Power et leurs comités techniques respectifs ont accompli un travail exceptionnel pour proposer des programmes de qualité.

**Les exposants** sont aussi des contributeurs à la bonne tenue des événements. Nous tenons à les remercier et plus particulièrement certains qui font preuve d'une fidélité sans faille.

Enfin, **les participants** aux workshops sont notre plus grande fierté mais également notre plus grande crainte de les voir bouder nos salles de conférences et les pause-café durant lesquelles les réseaux s'entretiennent et se forment.

C'est pourtant par cet écosystème que l'IMAPS France va perdurer.



	Chiffres d'affaires	Résultat d'exploitation
2017	81 354 €	- 32 236 €
2018	149 065 €	- 22 353 €
2019	194 402 €	660 €
2020f	85 000 €	- 67 000 €
2021f	130 000 €	- 35 000 €
2022f	180 000 €	500 €

**Pour 2020**, nous nous devons d'anticiper un bilan comptable désastreux. Nous avons commencé l'année en passant tout juste après les grèves contre la réforme des retraites avec l'évènement THERMAL2020 (voir la synthèse) dont le résultat ressort affaibli par rapport à 2019.

Nous tenons à vous expliquer ce côté financier de l'association afin de vous assurer de notre bonne gestion et de notre souci de travailler à un plan de sauvegarde 2020-2021 pour maintenir notre association et retrouver une stabilité financière.

N'hésitez donc pas à promouvoir notre association auprès de vos contacts, des étudiants et jeunes (ou moins jeunes) ingénieurs qui pourront s'épanouir dans cette activité du packaging électronique.

# 15<sup>th</sup> European Advanced Technology Workshop on Micropackaging and Thermal Management

– La Rochelle –

Jean-Yves Soulier

Zodiac Data Systems (Safran Group)

Chairman de la conférence



Dur mois de janvier où à l'issue de la première quinzaine, nous ne savions pas si notre événement pourrait avoir lieu, les grèves dans les transports décourageant les inscriptions. Le miracle de la deuxième quinzaine nous a permis d'accueillir avec soulagement plus de 80 personnes sur les deux journées, dont la plupart dès la veille du workshop pour cocktail de bienvenue qui ouvrait la quinzième édition de ce workshop et permettait de briser la glace entre exposants, conférenciers et auditeurs.

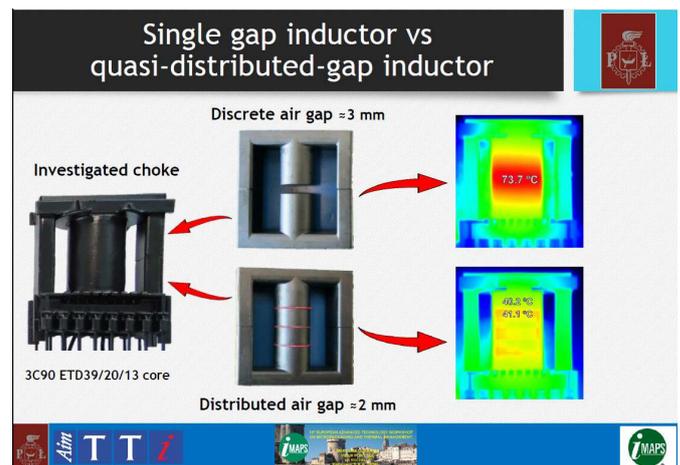
Rétrospectivement ce workshop m'apparaît comme une grande bouffée d'air et de rencontres techniques, un mois avant les événements inédits que nous connaissons et des situations que nos générations avaient oubliées depuis soixante ans.



Les membres de l'IMAPS pourront récupérer sur leur espace dédié du site internet

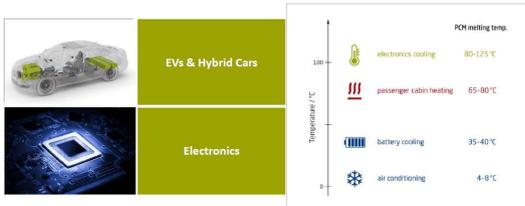
([www.imapsfrance.org](http://www.imapsfrance.org)) pas moins de 20 présentations marquées par une grande qualité technique et une quantité d'information que chaque chercheur ou ingénieur de développement pourra exploiter : beaucoup de résultats, de progrès techniques en méthodes de caractérisation (XLIM) ou mise au point de matériaux toujours plus conducteurs, d'applications (MBDA) ou d'exercices d'intégration (ICAM). IMAPS constitue une tribune pour la dissémination des résultats des projets financés par la communauté européenne ou l'Etat Français. Deux présentations (développement de nouvelles technologies de radiateur) donnent ainsi les avancées du projet ICOPE (Innovative COoling system for embedded Power Electronics) réunissant les Britanniques d'AAVID (Boyd Corporation), les Espagnols de l'université polytechnique de Catalogne, les Autrichiens de Schunk Technology gmbh et les Français de Thales Avionics Electrical Systems et développé dans le cadre du programme européen CleanSky2. Une troisième présentation sur un nouveau matériau fritté, œuvre d'ISP system, souligne que les travaux ont été financés par le dispositif RAPID, régime d'appui à l'innovation duale mis en place par la DGA.

Je retiens pour ma part la poursuite des travaux de Rafal Kasikowski, disciple de Boguslaw Wiecek de l'université de Lodz, fidèle et pilier de du workshop, sur l'optimisation des architectures de composants bobinés pour en réduire les échauffements :



Des travaux d'intégration de matériaux à changement de phase développés par Schunk Carbone Technology pour réduire l'échauffement de batteries lithium-ion trouveront sûrement des débouchés.

- Latent Heat Carbon is a novel solution for thermal management applications
  - Storage and release of thermal energy – for cooling or heating applications
  - Passive thermal management – lightweight & simplified module design



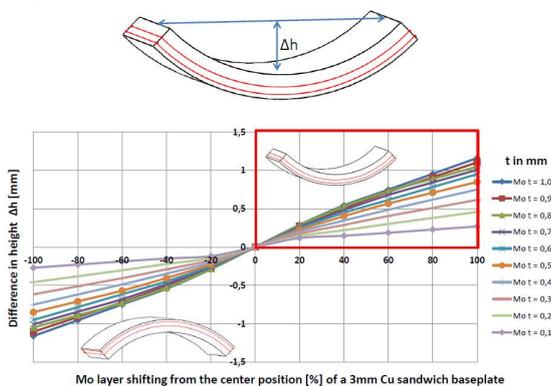
02/2020 AB, HL // Thermally Optimized Battery Packs Confidential: Copy or any passing on only with written permission of Schunk Carbon Technology GmbH 8

La mise en œuvre des manipulations du SuperGrid Institute (Villeurbanne) sur les thermosiphons constitue un appel à la lecture et l'analyse de cette présentation :



De la thermique à la thermomécanique, il n'y a qu'un pas franchi par Ronald Eisele de l'université de Kiel qui remet au goût du jour le molybdène pour réduire les écarts de dilatation thermique et augmenter la fiabilité long-terme en cycles thermiques des substrats portant le silicium des modules de puissance.

Solution: Hybrid Metal Baseplate  
Concept of a "Balanced Bi-Metal" DBC-Baseplate-Design



Eisele/Söhl FH Kiel – IMAPS France 2020 - Pump-out

La première journée de conférences s'achevait par le traditionnel social event précédé d'une nouvelle visite de l'aquarium voisin où, quinzième anniversaire oblige, un nouveau cocktail nous attendait et permettait à chacun de débriefer cette

première journée et de poursuivre le développement de son réseau professionnel.



Le succès de ce workshop tient comme toujours dans le soutien de nos exposants et la présence de nos piliers internationaux que sont désormais Ari Glezer du Georgia Tech Institute, Boguslaw Wiecek déjà cité, David Saums et ses très précieuses compilations. Je me répète depuis plusieurs années, mais il doit toujours à la qualité du travail de préparation et de formation des étudiants réalisé par Jean-Pierre Fradin de l'ICAM. Il doit au comité technique que je remercie encore pour avoir aidé à l'élaboration du programme et la présidence des sessions. Il n'existerait pas sans l'abnégation de Florence et le travail en coulisses du bénévole Reynald Deroche-Fontaine, vraies chevilles ouvrières du workshop.



## 8ème Forum MiNaPAD

Alexandre Val

Président du Forum

Nous vous présentons l'avancement du huitième forum MiNaPAD (Micro/Nano-Electronics Packaging and Assembly, Design and Manufacturing) dont les dates ont été modifiées du fait de la pandémie Covid-19 :

### Anciennes dates



### Nouvelles dates



En effet, l'équipe MiNaPAD avait construit un programme sur deux jours regroupant 38 papiers et couvrant l'ensemble des thèmes du Packaging en électronique. Tout était prêt pour accueillir une centaine de participants voire plus autour du salon des exposants.

Plusieurs scénarii s'offraient à nous :

**Déplacement en septembre ou octobre de cette année :** tous les salons français et européens ont reporté leurs activités sur le 4<sup>ème</sup> trimestre ce qui nous rendait peu visible !

**Annulation de l'évènement :** MiNaPAD représente la moitié de notre budget de fonctionnement en termes de recettes. A cette perte s'ajoute le remboursement des acomptes exposant, ce qui mettait l'association en quasi faillite. De plus, le travail de 9 mois de préparation aurait été mis à la poubelle !

**Report au plus tôt en 2021 :** c'est le compromis qui a été validé avec ces nouvelles dates début Février 2021 juste avant le début des vacances scolaires.

Ce compromis est à la fois technique, pour conserver le maximum de conférences du programme initial et le maximum d'exposants, et financier puisque la région grenobloise reporte sa subvention jusqu'en début d'année 2021 (l'entrée sera offerte aux étudiants) d'une part et nous garantit un flux de trésorerie plus accommodant. Nous allons ainsi tester cette inversion de calendrier avec THERMAL et tenter de relever ce défi.

Et certains y trouveront peut-être l'occasion d'un week-end ski !

Si ce nouveau calendrier obtient la satisfaction de la majorité des exposants et participants, alors il sera reconduit.

### Nouvelles Dates MiNaPAD 2021

Call for Papers : Juin 2020

Notification des orateurs : Novembre 2020

Programme : Décembre 2020

Comme je vous l'avais signalé lors de la dernière édition de notre journal, l'évènement MiNaPAD peut être l'occasion, pour les participants, d'organiser en parallèle des réunions d'avancement de projets, européens par exemple ; le centre des expositions étant réservé la veille par IMAPS pour l'installation des stands ; une salle voire l'auditorium sont ainsi disponibles.

## 12<sup>ème</sup> Forum Power 2020

### From Nano to Macro Power Electronics & Packaging Workshop 2020



#### Stéphane BELLENGER – STMicroelectronics General Chairman

Notre workshop Power Electronics sera le prochain évènement IMAPS depuis le début du confinement, et nous sommes tous impatients de partager de nouvelles conférences et rencontres professionnelles dans le cadre de notre association. Nous resterons vigilants sur la situation sanitaire telle qu'elle sera en octobre et novembre afin de mettre en place tous les moyens nécessaires pour un déroulement de cet évènement en toute sécurité et sérénité dans l'intérêt de nos conférenciers, auditeurs et partenaires.

Ce 12<sup>ème</sup> évènement se déroulera le 26 Novembre prochain, et se prépare depuis le mois de Février avec l'IMAPS France et la core team du Workshop. Celle-ci se rajeunit très heureusement avec le soutien actif de Franck Dosseul de la société Moduleus en Touraine et de Sébastien Jacques du Laboratoire Greman qui nous accueille depuis toutes ces années. Pour les porteurs du flambeau de cet évènement depuis 12 ans que sont le professeur Daniel Alquier de l'Université François Rabelais et du Laboratoire Greman, Christophe Serre et moi-même de la société ST-Microelectronics, c'est une opportunité importante de réflexions et de nouvelles approches de sujets et de réseaux pour aborder les prochaines années de conférence et rester au cœur des sujets scientifiques et technologiques touchant aux applications de puissance. Une réflexion est en cours pour élargir cet évènement avec d'autres partenaires tourangeaux, et explorer de nouvelles thématiques périphériques à notre thématique centrale.

L'évènement consacré aux procédés et technologies de packaging dédiés aux applications de puissance liées à la conversion ou à la récupération d'énergie, se déroulera de nouveau à

l'auditorium du Greman situé dans l'école Polytech, 7 avenue Marcel Dassault à Tours. Le hall d'entrée sera dédié à l'exposition des stands de nos partenaires fournisseurs de matériaux, d'outils de caractérisation, d'équipements ou de services, laboratoires et instituts. Ce lieu très accueillant reste bien adapté, et nous remercions le Greman de bien vouloir nous le mettre gracieusement à disposition.

Notre comité technique est constitué depuis Mars. Je remercie sincèrement l'ensemble de cette équipe pour le travail accompli au sein de notre comité depuis plusieurs années pour la plupart.

#### *Ce comité technique est de nouveau international :*

M. Lars Boëtcher, Fraunhofer Institut, Allemagne  
M. Cyril Buttay, Laboratoire Ampère, France  
M. Guillaume Callerant, Société Sonceboz, Suisse  
M Jean-Luc Diot, intervenant à titre privé, France  
M. Franck Dosseul, Société Moduleus France  
M. Sébastien Jacques, Laboratoire Greman, France  
M. Guo-Quan Lu, Institut Virginia Tech, USA  
M. Jürgen Schuderer, Société ABB, Suisse  
Mr. Daniel Alquier, Laboratoire Greman, chairman  
M. Christophe Serre, Société STM, chairman  
M. Stéphane Bellenger, Société STM, chairman

Pour cette 12<sup>ème</sup> édition, nous garderons les points forts et les pratiques qui ont été plébiscités depuis déjà quelques années, et d'autres testés plus récemment. La journée se déroulera en anglais pour continuer d'accueillir un comité technique, des présentateurs et un auditoire très élargi.

Nous accueillerons une dizaine de partenaires dans le hall et présenterons de nouveau sous forme de « micro-trottoir », leurs activités, produits ou services. L'animation a été appréciée et permet d'animer les inter sessions.

La journée sera rythmée par trois sessions, par une douzaine de papiers dont deux keynotes. Les sessions sont orchestrées selon un axe application et design, un axe matériaux, procédés et technologies et un troisième axe qualité et fiabilité.

Les papiers attendus sont résolument issus de développements techniques et technologiques,

alors que les keynotes poseront une vision des besoins marché et applicatifs, et de leur traduction en roadmap de développements technologiques.

Un café-croissant vous accueillera avant le premier keynotes. Une pause-café en matinée, une autre en après-midi permettront un libre échange entre les différentes personnes présentes ainsi qu'avec nos partenaires sur leurs stands. La formule déjeuner reste l'organisation d'un buffet gastronomique dans le hall, au milieu des stands pour continuer nos échanges et animer le micro-trottoir.

Enfin, la journée se clôturera sous de bons auspices, par un évènement social qui fleure bon le terroir (Visite guidée d'un site historique, d'une activité ou d'un métier artisanal, ...), puis d'un diner aux saveurs régionales.

Le traditionnel appel à papier (Call-for-paper) a été émis au tout début d'Avril, et vous sollicite dès à présent. Il vous suffit d'envoyer le sujet que vous souhaitez présenter, sous forme d'un titre et d'un résumé d'une centaine de mots maximum. La clôture de la réception des abstracts est fixée au 30 Juin.

En tant qu'organisateur de conférences, nous sommes toujours surpris par l'auto-censure silencieuse de notre communauté scientifique et technologique qui, avec l'expérience que confèrent les années de pratique du développement, nous conduit à dévaloriser nos propres sujets, nous persuade que ceux-ci n'offrent pas une matière, un intérêt ou une originalité suffisants pour être soumis et présentés lors de cette journée. Le retour de nos auditeurs nous confirme que vos papiers nous intéressent, intéressent la communauté technique, intéressent les jeunes ingénieurs et chercheurs d'aujourd'hui.

Alors à vos plumes et claviers ! Nous avons hâte de lire vos propositions de sujet.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Technologiquement vôtre,  
Stéphane



CALL FOR PAPERS

From Nano to Macro  
Power Electronics and Packaging  
European Workshop

November the 26<sup>th</sup>, 2020 - TOURS, FRANCE



Following the success of the *Power Electronics Workshop* organized over the past 11 years in partnership with GREMAN (UMR 7347) and Polytech-Tours, sponsored by ST-Microelectronics, CERTeM and Polytech Tours, IMAPS-France proudly announces the 12<sup>th</sup> edition of the *Power Electronics and Packaging Technical Workshop* to be held in Tours, France on **Thursday, November the 26<sup>th</sup>, 2020**. The city of Tours is located along the scenic Loire Valley which is famous for its castles built along the river. The event will be held in English for the 8<sup>th</sup> consecutive year. *Please, don't miss the date!*

**TECHNICAL COMMITTEE:**

Lars BOETTCHER	FRAUNHOFER Institute	Germany	
Cyril BUTTAY	AMPERE Laboratory	France	
Guillaume CALLERANT	SONCEBOZ	Switzerland	
Jean-Luc DIOT	INDEPENDANT	France	
Franck DOSSEUL	MODULEUS	France	Co-chairman
Sébastien JACQUES	GREMAN Laboratory	France	Co-chairman
Guo-Quan LU	VIRGINIA TECH	USA	
Jürgen SCHUDERER	ABB Corporate Research	Switzerland	
Christophe SERRE	ST Microelectronics-Tours	France	Co-chairman
Stéphane BELLENGER	ST Microelectronics Grenoble	France	Chairman

We invite speakers to submit abstracts relating to the following topics:

- Power management for transportation and industrial systems
- Energy harvesting systems, from nano to macro (smart grid, wind energy, photovoltaic, etc...)
- Energy conversion systems— from power to emission (lighting, ultrasonic, infrared, etc...)

These topics could be developed around several themes, such as:

- New materials and substrates dedicated to power electronics
- Thermal or thermo mechanical or regulatory constraints (RoHS regulation, REACH, etc...)
- Dedicated technologies for integration and optimisation of power systems, including passive components (weight and size reduction, yield improvement, efficiency, etc...)
- Innovative technologies, materials and processes dedicated to interconnection and packaging (die attach, bonding wires & ribbon wires, 3D power components, etc...)
- Reliability and failure modes (impacts linked to technologies, thermal constraints, radiation, etc...), predictive methods, design of experiments, reliability
- High current and high voltage or extremely high voltage: impact on packaging technologies

Presentations will be 25 minutes in length, including 5 minutes for questions and answers. The abstract submission deadline is June the 30<sup>th</sup>. Please submit abstracts in English (Conference official language) and word format, including the names of the company or institution, the speaker and associated author(s), the title of the conference and an abstract of 250-600 words. Paper acceptance will be communicated prior to July the 15<sup>th</sup>.

Following the first workshop day, IMAPS will organize in the evening a specific event followed by a diner.

For further information, please contact Florence VIRETON Tel: +33 (0) 1 39 67 17 73  
E-mail: [imaps.france@imapsfrance.org](mailto:imaps.france@imapsfrance.org); Web: <http://france.imaps-europe.org/>



# Annonces

## News Release

**Pour diffusion immédiate**

19 mars 2020

**Contact:** Roger Dullinger, Marketing Communications Manager

(952) 469-8278, [Roger.Dullinger@itweae.com](mailto:Roger.Dullinger@itweae.com)

---

## ITW EAE étend son accord avec Metronelec pour représenter les produits Vitronics Soltec en France

Lakeville, Minnesota, le 19 mars 2020 - ITW EAE annonce un nouvel accord de partenariat étendu avec Metronelec et W-Tech France pour représenter et distribuer les équipements de brasage Vitronics Soltec à partir du 1er avril 2020. Cet accord est une extension de la représentation de Metronelec de la gamme de produits ITW EAE qui comprenait déjà les machines de sérigraphie MPM, les systèmes de dosage de précision Camelot ainsi que des vagues et machines de nettoyage Electrovert.

«Metronelec a démontré une excellente capacité de représentation pour MPM, Camelot et Electrovert en France », a déclaré Wim Schouten, directeur des ventes pour ITW EAE. « Nous sommes très chanceux d'avoir cette équipe de pointe, techniquement expérimentée, qui représente la gamme complète d'équipements d'assemblage électronique ITW EAE. L'équipe de ventes de Metronelec est l'une des meilleures du secteur et on peut compter sur elle pour servir au mieux tous nos clients. »

« Nous sommes très heureux d'ajouter Vitronics Soltec à notre offre », a déclaré Emmanuel Anglade, président de Metronelec. « Vitronics Soltec est un pionnier de la technologie de brasage avec une réputation de technologie de pointe combinée à une haute qualité de fabrication et un support technique d'excellence. Nous sommes impatients d'ajouter cette gamme de machines à notre gamme actuelle ».

Metronelec est spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements et de consommables pour l'industrie électronique depuis 1975. En 2019, Metronelec a élargi son équipe avec l'acquisition de W-Tech. Metronelec et W-Tech seront responsables des ventes, du service et des pièces de rechange pour les machines de sérigraphie MPM, les systèmes de dosage sélectifs Camelot, les vagues, les vagues sélectives et les fours de refusion Vitronics Soltec, les solutions de brasage et les machines de nettoyage Electrovert, depuis le siège de Metronelec en région parisienne et le siège de W-Tech en région Rhône Alpes.

**Contact:** Alain Duflos; Directeur Commercial, Metronelec

Metronelec FRANCE, 6 Avenue Eiffel, 78420 Carrières-sur-Seine, France

[contact@metronelec.com](mailto:contact@metronelec.com) Phone: +33 (0)1 30 15 20 00

Le : 06 avril 2020 à 09:38 (GMT +02:00)

De : "A!MD : Jean-Louis DIVOUX" <jean-louis.divoux@aimd.fr>

À : "team-prrc@team-prrc.eu" <team-prrc@team-prrc.eu>

Cc : "Secretariat@team-prrc.eu" <Secretariat@team-prrc.eu>

Objet : TEAM-PRRC

Bonjour,  
Chers tous,

C'est avec plaisir que je vous informe de la création de TEAM-PRRC, association européenne à but non-lucratif des « Personnes Chargées de Veiller au Respect de la Réglementation » (« Persons Responsible for Regulatory Compliance » en anglais) selon l'article 15 des Règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 relatifs aux dispositifs médicaux. TEAM-PRRC vise à :

- Réunir les personnes chargées de veiller au respect de la réglementation (PRRC) des dispositifs médicaux telles qu'elles sont définies par la réglementation européenne ;
- Échanger sur les problèmes rencontrés par les PRRC dans leurs activités, proposer et échanger des solutions ;
- Établir, maintenir, développer un haut niveau de professionnalisme des PRRC ;
- Échanger avec les autorités de santé en charge de la réglementation nationale, européenne et internationale ;
- Intervenir à la demande d'une PRRC comme médiateur dans les contestations rencontrées dans son activité ;
- Œuvrer pour l'amélioration de la Santé Publique ;
- Œuvrer pour l'entraide entre les membres de l'association.

Nous construisons aussi d'autres propositions telles que l'accès à un espace d'échange réservé aux membres et aux entreprises en quête de ressources et de compétences.

Nous en créerons plus encore avec votre participation ! Voici le lien de notre site internet : [www.team-prrc.eu](http://www.team-prrc.eu)

Vous y trouverez toutes les informations et modalités d'inscription. N'hésitez pas et invitez vos connaissances à nous rejoindre !

PS : nous proposons un tarif de bienvenue 200 € (vs ~~250~~€) aux nouveaux membres qui nous rejoindront avant le 26 mai 2020.

Dans cette période incertaine, recevez mes salutations distinguées.

Jean-Louis DIVOUX

Secrétaire

[Secretariat@team-prrc.eu](mailto:Secretariat@team-prrc.eu)

TEAM-PRRC [www.team-prrc.eu](http://www.team-prrc.eu)



# Advancing Microelectronics Magazine

En tant que membre IMAPS-France, nous vous rappelons que vous avez un libre accès à l'excellente revue Advancing MicroElectronics Magazine. Dans cette revue trimestrielle vous trouvez toutes les actualités et des articles techniques sélectionnés au travers des différents événements américains.

Nous mettons à votre disposition ces documents sur notre site. En allant sur le site ImapsSource (<http://www.imapsource.org>), vous aurez accès à toutes les archives de cette revue ; n'hésitez pas à vous y inscrire.

## Edition 2019 :

Janvier/Février: **Device Packaging**

Mars/Avril: **Medical Electronics**

Mai/Juin: **Heterogeneous Integration – System in Package (SiP)**

Juillet/Août: **Glass panel embedding for 3D SiP**

Septembre/Octobre: **Advanced Materials and Additive Packaging**

Novembre/Décembre: **Chip Package Interaction (CPI)**

## Edition 2020 :

Janvier/Février: **Device Packaging**

### **The Bifurcation of Advanced IC Packaging**

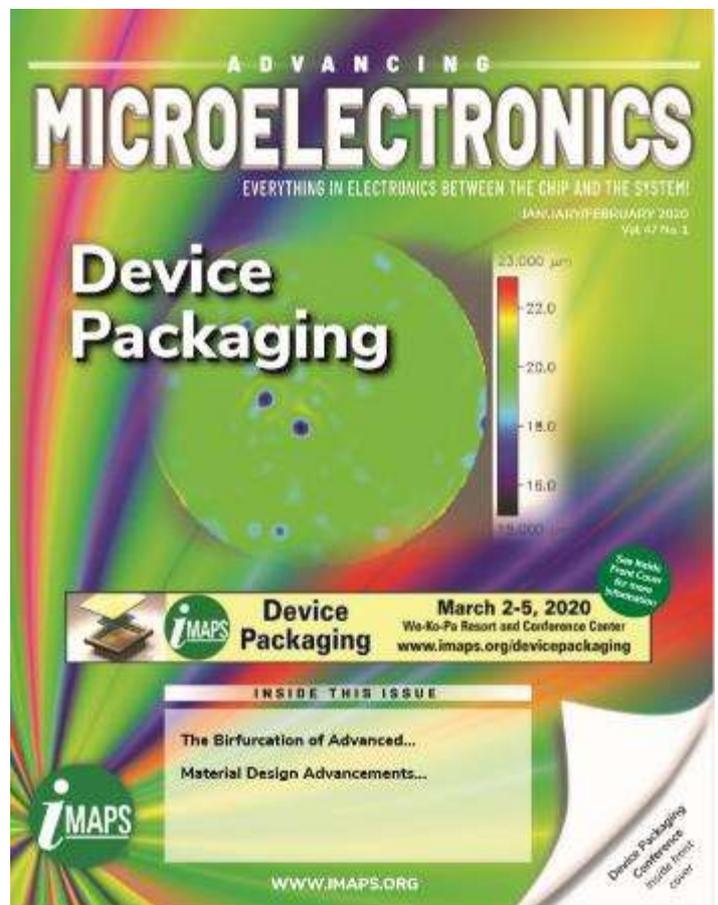
*John Park, Cadence, 2655 Seely Ave., San Jose, CA 95134 USA Ph: 408-321-8139,*

*Email: [jpark@cadence.com](mailto:jpark@cadence.com)*

### **Material Design Advancements Create Multifunctional Materials for Single-Layer Temporary Bonding and Debonding**

*Luke Prenger, Xiao Liu, Qi Wu, Rama Puligadda, Brewer Science, Inc., 2401 Brewer Dr., Rolla, MO 65401 United States Ph: 573-364-0300 x1818,*

*Email: [Lprenger@brewerscience.com](mailto:Lprenger@brewerscience.com)*



Pour tout renseignement complémentaire, contacter : Florence Vireton par messagerie : sur [imaps.france@imapsfrance.org](mailto:imaps.france@imapsfrance.org)

ou par téléphone au 01 45 05 72 32